

TOP DuNC プロセス

Decorative Electroplating Process on Resin

TOP DuNC PROCESS

- ピットが発生しにくい硫酸銅めっき
- 皮膜物性が良く、クラックが発生しにくい半光沢ニッケルめっき、光沢ニッケルめっき
- 低電流密度部のパウダー共析量が高く、高耐食性が得られるマイクロポーラスニッケルめっき
- つき回りが良く、陽極の溶解が少ないクロム(VI)めっき

- Acid copper plating: Prevent pits
- Semi-bright nickel plating, bright nickel plating: High film properties, prevent cracks
- Micro-porous nickel plating: High powder ratio even under low current density, improve corrosion resistance
- Hexavalent chromium plating: Great covering performance, reduce anode dissolution

処理工程 Process



- クロム(VI): TOP DuNC CR
Hexavalent chromium plating: TOP DuNC CR
- クロム(III): トップファインクロムシリーズ
Trivalent chromium plating: TOP FINECHROME series
- クロム(III): トップファルベシリーズ
Trivalent chromium plating: TOP FARBE series

マイクロポーラスニッケルめっき: 高耐食性 Micro-porous nickel plating: High corrosion resistance



腐食分散性に優れ、高い耐食性
High corrosion resistance can be realized by its corrosion spreading power

	TOP DuNC MP	従来浴 Conventional bath
①	9,000	2,000
②	12,000	16,000
③	21,000	114,000*
④	30,000	15,000
⑤	15,000	2,000

表内: パウダー共析数 (個/cm²) *過剰共析により、外観白化
Co-deposited powder amount (Powder amount/cm²)
*Excessive powders cause whitish appearances.

硫酸銅めっき: ピットが発生しにくい Acid copper plating: Prevent pits

ピットが抑制され、外観が向上
Prevent pits, improve appearances



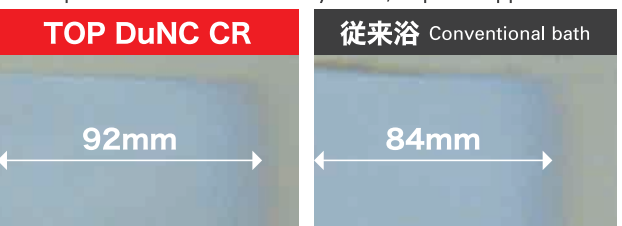
半光沢ニッケルめっき/光沢ニッケルめっき: 優れた皮膜物性 Semi-bright nickel plating/Bright nickel plating: Great film properties

皮膜物性が良く、クラックを抑制
High film properties, prevent cracks



クロムめっき: 優れたつき回り性 Chromium plating: Great covering power

低電流部まで析出し、良好な外観
Can deposit to low current density areas, improve appearances



※クロムハルセル試験(5A, 2分)のクロム被覆幅の値
※Chromium plating coverage width (Hull-cell test at 5A, for 2min)